

华天科技HUATIAN

天水华天科技股份有限公司成立于2003年12月25日，2007年11月20日在深圳证券交易所挂牌上市交易。股票简称：华天科技；股票代码：002185。目前，公司总股本213,111.29万股，注册资本213,111.29万元。

公司主要从事半导体集成电路封装测试业务。目前公司集成电路封装产品主要有DIP/SDIP、SOT、SOP、SSOP、TSSOP/ETSSOP、QFP/LQFP/TQFP、QFN/DFN、BGA/LGA、FC、MCM (MCP)、SiP、WLP、TSV、Bumping、MEMS等多个系列，产品主要应用于计算机、网络通讯、消费电子及智能移动终端、物联网、工业自动化控制、汽车电子等电子整机和智能化领域。

近几年来，公司不断加强封装技术和产品的研发力度，加大研发投入，完善以华天西安为主体的研发仿真平台建设，通过实施国家科技重大专项02专项等科技创新项目以及新产品、新技术、新工艺的不断研究开发，自主研发出FC、Bumping、MEMS、MCM (MCP)、WLP、SiP、TSV、Fan-Out等多项集成电路封装技术和产品，随着公司进一步加大技术创新力度，公司的技术竞争优势将不断提升。

公司拥有稳定的客户群体和强大的销售网络，得到了客户的广泛信赖，建立了良好的合作关系。近几年来公司在稳步扩展国内市场的同时，通过采取加大国际市场的开发及境外并购等措施，有效的拓展了国际市场，已形成布局全球的销售格局，为公司的发展提供了有力的市场保证，降低了市场风险。

多年来，公司在不断扩大产业规模，提高技术水平的同时，通过持续不断的技术和管理创新，使公司保持了健康持续快速的发展。公司拥有一支善于经营、敢于管理、勇于开拓创新、团结向上的经营管理团队；公司法人治理结构完善，各项管理制度齐全；多年的大生产实践，公司已

形成了一套先进的大生产管理体系。

公司将坚持以发展为主题，以科技创新为动力，以产品结构调整为主线，倡导管理创新、产品创新和服务创新，在扩大和提升现有集成电路封装业务规模与水平的同时，大力发展BGA、MCM（MCP）、SiP、FC、TSV、MEMS、Bumping、Fan-Out、WLP等封装技术和产品，扩展公司业务领域，提升核心业务的技术含量与市场附加值，努力提高市场份额和盈利能力。

本文链接：<https://dqcm.net/wenan/htkjhuat-964318.html>